

Portapiastrine In Silicio In Ptfе Per Processi Di Incisione Acida E Pulizia 2 4 6 8 Pollici Personalizzabile Resistente Alle Alte Temperature

Numero articolo: PL-CP158



Introduzione

Portapiastrine in silicio in PTFE ad alta purezza progettati per processi di incisione acida estrema e pulizia. Ottimizzati per piastrine da 2 a 8 pollici, questi robusti portapiastrine personalizzabili garantiscono una manipolazione senza contaminazioni e stabilità termica negli ambienti di produzione semiconduttori più impegnativi per l'approvvigionamento B2B.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Incisione di semiconduttori	Manipolazione di piastrine in soluzioni concentrate di HF o BOE (incisione di ossido tamponato) per rimuovere strati dielettrici.	Eccezionale resistenza agli acidi aggressivi garantisce una durata a lungo termine del portapiastrine.
Processi di pulizia RCA	Utilizzo di soluzioni SC-1 e SC-2 a temperature elevate per rimuovere contaminanti organici e metallici.	L'elevata stabilità termica previene la deformazione durante bagni ossidativi ad alta temperatura.
Produzione di celle fotovoltaiche	Texturizzazione e pulizia di piastrine in silicio durante la produzione di celle solari ad alta efficienza.	Il design robusto gestisce la produzione industriale ad alto volume con affidabilità costante.
Fabbricazione MEMS	Trattenimento sicuro dei substrati durante processi complessi di incisione ionica reattiva profonda e di rilascio umido.	Gli slot lavorati con precisione proteggono le delicate strutturmecaniche dai danni da contatto.
Pulizia con incisione Piranha	Lavorazione di piastrine in una miscela di acido solforico e perossido di idrogeno per rimuovere composti organici pesanti.	I materiali sono immuni agli attacchi ossidativi forti, prevenendo la degradazione dell'apparecchiatura.
Ricerca in nanotecnologia	Manipolazione specializzata di substrati personalizzati in deposizione chimica da vapore sperimentale o lavorazione in fase liquida.	La piena personalizzazione consente il supporto di dimensioni di piastrine non standard e geometrie uniche.
Assemblaggio optoelettronico	Pulizia di piastrine di zaffiro o GaAs prima della crescita epitassiale o della deposizione di film sottili.	La purezza del materiale PTFE elimina il rischio di interferenza da tracce metalliche nei dispositivi ottici.
Categoria di specifica	Dettagli dei parametri per PL-CP158	Disponibilità/Opzioni
Serie di modelli	Portapiastrine in silicio PL-CP158	Progetti standard e personalizzati
Materiale primario	PTFE (Politetrafluoroetilene) ad alta purezza	Opzioni PFA disponibili su richiesta
Dimensioni di piastrine compatibili	2 pollici, 4 pollici, 6 pollici, 8 pollici	Completamente personalizzabile per qualsiasi diametro
Configurazione slot	Capacità e passo definiti per progetto	Personalizzato secondo le specifiche dell'utente
Intervallo di temperatura	Operativo da livelli criogenici a 260°C	Personalizzazione dipendente dal processo
Resistenza chimica	Gamma completa di acidi, basi e solventi	Compatibilità chimica universale
Metodo di fabbricazione	Lavorazione di precisione CNC a 5 assi	Geometria su misura disponibile
Caratteristiche di drenaggio	Porte di drenaggio inferiori/laterali personalizzabili	Ottimizzato per portate di bagno specifiche

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Categoria di specifica	Dettagli dei parametri per PL-CP158	Disponibilità/Opzioni
Design della maniglia	Maniglie staccabili o integrate manuali/robotiche	Personalizzato per compatibilità con gli strumenti
Grado di purezza	Analisi delle tracce e grado semiconduttore	Materiali certificati ad alta purezza